

证券代码：002916

证券简称：深南电路

深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-09

投资者关系 活动类别	√ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 现场参观 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 其他（_____）
活动参与人员 （排名不分先后）	中国国新
上市公司 接待人员	副总经理、董事会秘书：张丽君；投资者关系经理：郭家旭
时间	2025 年 3 月 18 日
地点	公司会议室
形式	实地调研
投资者关系 活动主要内容介绍	交流主要内容： Q1、请介绍公司主营业务基本情况。 公司专注于电子互联领域，拥有印制电路板、电子装联、封装基板三项主营业务，形成了业界独特的“3-In-One”业务布局，印制电路板与封装基板业务“技术同根”，电子装联与印制电路板业务“客户同源”，三项业务在各自领域相继拓展的同时，高效协同共筑起公司电子电路互联技术能力平台。公司具备提供“样品→中小批量→大批量”的综合制造能力，通过开展方案设计、制造、电子装联、微组装和测试等全价值链服务，能够为客户提供专业高效的一站式综合解决方案。业务产品下游应用广泛，拥有较为深厚的行业积淀和扎实的客户基础。 Q2、请介绍 2024 年公司 PCB 业务营业收入及毛利率的变动原因。 2024 年，PCB 业务实现主营业务收入 104.94 亿元，同比增长 29.99%；毛利率 31.62%，同比增加 5.07 个百分点。PCB 业务充分把握算力以及汽车电子市场的机遇，实现营收和利

	润的稳健增长。PCB 业务营收层面的增长贡献主要集中在通信领域 400G 及以上的高速交换机、光模块产品需求增长；数据中心领域 AI 服务器及相关配套产品需求增长，以及服务器总体需求显著回温；汽车电子领域电动化/智能化趋势促进订单需求持续释放。 PCB 业务毛利率的增长得益于营收规模增加，PCB 工厂产能利用率提升，AI 相关领域订单需求增长助益 PCB 业务产品结构优化。同时，公司针对性开展多项运营管理能力提升工作，通过提升原材料利用率、前置引导客户设计、优化能源管理等多种方式强化成本竞争力，并针对部分瓶颈工序进行技术提效，保障高效产出，对 PCB 业务毛利率的提升起到正向作用。 Q3、请介绍 2024 年公司封装基板业务营业收入及毛利率的变动原因。 2024 年，封装基板业务实现主营业务收入 31.71 亿元，同比增长 37.49%；毛利率 18.15%，同比减少 5.72 个百分点。封装基板业务在全球基板行业温和修复的环境下，加大市场拓展力度，加快推进新产品和新客户导入，推动订单较去年增长。封装基板业务毛利率的下降主要由于广州封装基板项目爬坡、金盐等部分原材料涨价，叠加下半年 BT 类基板市场需求波动、基板工厂产能利用率有所下降等因素共同影响。 Q4、请介绍公司封装基板业务在 FC-BGA 产品方面取得的进展。 公司 FC-BGA 封装基板已具备 16 层及以下产品批量生产能力，18、20 层产品具备样品制造能力，各阶产品相关送样认证工作有序推进，20 层产品目前在客户端认证环节已取得比较良好的结果。 Q5、请介绍公司广州封装基板项目连线爬坡进展。 公司广州封装基板项目一期已于 2023 年第四季度连线，产品线能力持续提升，产能爬坡稳步推进，已承接包括 BT 类及部分 FC-BGA 产品的批量订单，但总体尚处于产能爬坡早期阶段，重点仍聚焦能力建设，由此带来的成本及费用增加，对公司利润造成一定负向影响。 Q6、请介绍公司 PCB 业务主要产品下游应用分布情况。 公司在 PCB 业务方面从事高中端 PCB 产品的设计、研发及制造等相关工作，产品下游应用以通信设备为核心（覆盖无线侧及有线侧通信），重点布局数据中心（含服务器）、汽车
--	---

	电子（聚焦新能源和 ADAS 方向）等领域，并长期深耕工控、医疗等领域。其中，数据中心领域在 2024 年度成为公司 PCB 业务继通信领域之后，第二个达 20 亿元级订单规模的下游市场。 Q7、请介绍公司的技术研发体系/研发模式。 公司坚持自主创新的发展战略，通过设置三级研发体系，在公司总部、事业部和生产厂层面分别下设研发部、产品研发部和技术部，从打通样品研发工艺到产线批量生产形成有效衔接与配合，推动公司技术能力综合提升，奠定了公司从工艺技术到前沿产品开发的行业竞争优势。 Q8、请介绍公司近期产能利用率情况。 公司 PCB 业务因目前算力及汽车电子市场需求延续，近期工厂产能利用率仍保持在高位运行；封装基板业务受近期存储领域需求相对改善，工厂产能利用率环比第四季度略有提升。 Q9、请介绍公司 PCB 业务近年来扩产规划。 公司 PCB 业务在深圳、无锡、南通及泰国项目（在建）均设有工厂。一方面，公司可通过对现有成熟 PCB 工厂进行持续的技术改造和升级，增进生产效率，释放一定产能；另一方面，公司在南通基地尚有土地储备，具备新厂房建设条件，南通四期项目已有序推进基建工程，拟建设为具备覆盖 HDI 等能力的 PCB 工艺技术平台。公司将结合自身经营规划与市场需求情况，合理配置业务产能。 Q10、请介绍公司业务目前是否涉及玻璃基板产品。 玻璃基板与 PCB、有机封装基板在材料特性、生产工艺方面均存在差异，在各自的应用领域具有不同特征。公司对玻璃基板技术保持密切关注与研究，目前不涉及玻璃基板的生产。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。

附件清单	无
------	---